

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2026-026

南京晶升装备股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意南京晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,459.1524万股，每股发行价格为人民币32.52元，募集资金总额为1,124,916,360.48元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于2023年4月17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年4月17日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]210Z0014号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资

金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币300.19万元。公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年4月17日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	112,491.64
其中：超募资金金额	54,010.00
减：直接支付发行费用	10,861.24
二、募集资金净额	101,630.40
减：	
以前年度已使用金额	17,392.90
本年度使用金额	4,768.83
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	36,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.06
其他-永久补充流动资金（含利息）	47,140.31
加：	
募集资金利息收入	361.11
其他-闲置募集资金现金管理收益	3,610.78
三、报告期期末募集资金余额	300.19

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

2023年4月10日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）、华泰联合证券、招商银行股份有限公司南京栖霞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年1月29日，为配合公司经营管理需要，提高募集资金的管理效率，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，同意将募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”对应的募集资金专用账户进行变更。晶升半导体已于2024年2月2日在南京银行股份有限公司南京紫东支行新设立了募集资金专用账户，并与公司、南京银行股份有限公司南京分行及华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，原募集资金专用账户已注销，其募集资金四方监管协议相应终止。

上述募集资金专户存储三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年4月17日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
晶升股份	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169200000002784	-	已注销
晶升股份	南京银行股份有限公司珠江支行	0156240000003576	6.67	存续
晶升股份	中信银行股份有限公司南京月牙湖支行	8110501014302164110	-	已注销
晶升股份	中国民生银行股份有限公司南京北京西路支行	638997799	-	已注销
晶升半导体	南京银行股份有限公司南京紫东支行	0169270000003520	293.53	存续
晶升半导体	招商银行股份有限公司南京栖霞支行	125914172310603	-	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

2025年4月28日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币55,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年4月17日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
80,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月（含）的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2024年4月29日	2025年4月28日	2024年4月29日

55,000.00	购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品	2025年4月28日	2026年4月27日	2025年4月28日
-----------	---	------------	------------	------------

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023年4月17日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南京晶升半导体科技有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2025年4月21日	2026年4月16日	2026年4月16日	6,500.00	2.20%	143.00
南京晶升装备股份有限公司	南京银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	保本浮动收益	16,500.00	2025年5月9日	2026年5月6日	2026年5月6日	16,500.00	2.10%	\
南京晶升半导体科技有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025年7月30日	2026年2月9日	2026年2月9日	5,000.00	2.05%	55.24
南京晶升半导体科技有限公司	南京银行股份有限公司南京紫东支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025年11月6日	2026年4月20日	2026年4月20日	2,000.00	2.04%	18.70
南京晶	南京银	结构性	保本浮	4,000.00	2025年	2026年1	2026年1	4,000.00	2.00%	7.78

升半导 体科技 有限公 司	行股份 有限公 司南京 紫东支 行	存款	动收益		12月8日	月12日	月12日			
南京晶 升半导 体科技 有限公 司	南京银 行股份 有限公 司南京 紫东支 行	结构性 存款	保本浮 动收益	2,000.00	2025年 12月24 日	2026年1 月26日	2026年1 月26日	2,000.00	1.90%	3.48

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年7月14日召开公司第二届董事会第十二次会议，并于2025年8月4日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意将部分超募资金人民币16,000.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.62%。该超募资金为《上市公司募集资金监管规则》实施前已发行完成并取得的，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，适用旧规则，且公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年4月17日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	16,000.00	2025年7月14日	2025年8月4日

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2025年6月5日，公司已将存放于南京银行股份有限公司南京紫东支行（银行账号：0169200000002784）账户内的节余募集资金全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动，并注销该账户。

具体内容详见公司于2025年3月28日、2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）、《南京晶升装备股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-030）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023年4月17日				
节余募集资金合计金额			7,669.75				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
总部生	7,669.75	用于补	不适用	不适用	不适用	2025年	\

产及研发中心建设项目		流				3月27	
------------	--	---	--	--	--	------	--

（八）募集资金使用的其他情况

1、将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募集资金投资项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”总投入募集资金金额的情况下，公司拟通过无息借款的方式将募集资金人民币20,255.00万元划转至该募集资金投资项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司晶升半导体的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限自实际借款之日起，至募集资金投资项目实施完成之日止，根据项目实际情况，到期后可续借或提前偿还。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-003）。

为优化晶升半导体的资产负债结构，增强其资金实力，支持其良性运营和可持续发展，公司于2026年1月23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将对晶升半导体提供的人民币20,255.00万元的募集资金借款转为对晶升半导体增资以实施募投项目“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”。具体内容详见公司于2026年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-006）。

2、使用自筹资金支付募集资金投资项目款项后续以募集资金等额置换

公司于2023年5月15日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京晶升装备股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的实施地点和实施方式进行了变更，项目和投资用途未变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，晶升股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶升股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，晶升股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用等情形；截至2025年12月31日，晶升股份募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对晶升股份在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称							2023 年首次公开发行股份						
募集资金到账日期							2023 年 4 月 17 日						
本年度投入募集资金总额							12,239.39						
已累计投入募集资金总额							61,632.29						
变更用途的募集资金总额							0.00						
变更用途的募集资金总额比例							0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
总部生产及研发中心建设项目	生产建设	无	27,365.39	27,365.39	27,365.39	4,028.65	20,551.89	-6,813.50	75.10	2025 年 3 月	9,046.86	不适用	否
半导体晶体生	生产建设	无	20,255.00	20,255.00	20,255.00	740.18	1,609.84	-18,645.16	7.95	2027 年 12 月	不适用	不适用	否

长设备总装测试厂区建设项目													
承诺投资项目小计	/	/	47,620.39	47,620.39	47,620.39	4,768.83	22,161.73	-25,458.66	46.54	/	/	/	/
超募资金	/	/	54,010.00	54,010.00	不适用	7,470.56	39,470.56	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			101,630.39	101,630.39	/	12,239.39	61,632.29	/	/	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>由于《南京市江北新区智能制造产业发展管理办公室与南京晶升装备股份有限公司项目合作协议》无法按预期计划实施，若继续推进将耗费更多的时间及延长募投项目的建设周期，故为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，同时结合公司产能和研发的需求，拟对“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”进行延期及变更。公司于2023年10月30日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案》，对该项目的实施地点及实施方式进行变更，并将该项目的预定建设完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。</p> <p>为持续推进相关募投项目建设进度，保障募投项目顺利实施，同时根据当地政府对区域内土地资源产业化配置的长远规划，公司于2024年1月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，对该项目的实施地点进行变更。</p> <p>公司已与南京经济技术开发区管理委员会签署《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书》以及《半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目投资协议书补充协议》。</p> <p>受宏观经济周期性波动、行业需求阶段性放缓、审批流程等客观因素的影响，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“半导体晶体生长设备总装测试厂区建设项目”的预定建设完成日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。</p>												

	截至本报告披露日，上述项目已完成土地出让手续。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部生产及研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目的节余金额为 7,669.75 万元，形成原因主要是：1、在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低项目成本和费用。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。3、节余募集资金包含本项目尚未支付的尾款、质保金等款项。由于上述款项在项目建设完成时尚未满足支付条件或期限，因此未支付完毕。
募集资金其他使用情况	详见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：总部生产及研发中心建设项目于 2025 年 3 月结项，未满一整年，故“是否达到预计效益”为不适用。